

# INTERMOLD 2016

第 27 回金型加工技術展

The Future of Making Things

シミュレーションと CAM による「ものづくりの未来」

オートデスクブースでは、樹脂流動解析で高い実績を誇る Autodesk Moldflow を中心に、Helius、Nastran、CAM などの最新情報を国内初披露します。また、スポンサー企業による対応ポッドやユーザー様のサンプルも展示。製品の機能や活用方法等を詳しくご紹介するワークショップや、「ものづくりの未来」をテーマに 3D プリントを身近にするためのオートデスクの取り組みをご紹介する特別講演も開催します。

会 期

2016 年 4 月 20 日(水) ~ 23 日(土) 10:00-17:00 (最終日 23 日は 16:00 まで)

会 場

インテックス大阪 大阪府大阪市 住之江区南港北 1-5-102

ブース No.

6B - 601

参加費

1,000 円 (招待券持参者および事前来場登録者は無料)

オートデスク  
ブース スポンサー企業

**iSiD**  
IT Solution Innovator  
株式会社 電通国際情報サービス

**CAD Solutions**

**FUJITSU**

**RCCM**

デジタルものづくり産協企業  
株式会社 システムクリエイト  
(順不同)

サンプル展示協力

川崎重工業 様 / パナソニック 様 / 富士精工 様 / ワイテック 様 他 (順不同)

## テクニカルワークショップ

「安心してください。  
シミュレーションがありますよ。」

樹脂流動解析 Autodesk Moldflow の  
最新機能と事例のご紹介

オートデスク株式会社  
シミュレーション スペシャリスト  
宮崎 寿



金型修正のコストと時間を削減できないとお悩みの方は必見！  
CAD に戻ることなく、CAE 上で形状改善をする新機能なども含めた、Autodesk Moldflow の最新情報をお届けします。  
金型製作前に軽量化のための最適な製品肉厚の決定やハイサイクル化、品質向上を実現します。

日程：2016 年 4 月 22 日 (金)  
15:00-16:00

場所：インテックス大阪 6B 号館内特設会場

受講：無料

定員：80 名 (予約不要・先着順)  
受付時に名刺をご用意ください

## 特別講演

『試作・デザイン・解析&3Dプリンティングフェア』

「The Future of Making Things  
with 3D Printing」

～ 3D プリントが変える。最新技術と  
事例からみるものづくりの未来 ～

オートデスク株式会社  
技術営業本部マネージャー  
加藤 久喜



航空機製造大手のエアバス社とのキャビン内で使用するパーテーションを軽量化する共同開発の事例や、新しいものづくり環境に対応する技術開発など、グローバルのトレンドをご紹介します。また 3D プリントを身近にするための弊社の取り組み、3D プリントに最適な形状を生成するツールなどもご紹介します。

日程：2016 年 4 月 20 日 (水)  
15:00 ~ 16:30 (受付開始 14:40)

場所：インテックス大阪 国際会議ホール

受講：無料

定員：約 300 名 (スクール形式・事前登録制)  
受付時に名刺をご用意ください

詳細はこちら

JAPAN INTERNATIONAL DIE & MOLD MANUFACTURING TECHNOLOGY EXHIBITION  
**INTERMOLD 2016**  
第27回金型加工技術展

<https://www.intermold.jp/>